

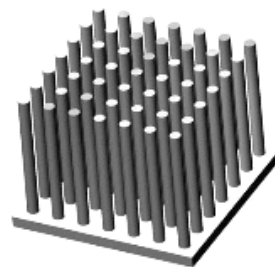


Produktinformation Type: PB2525/10/SE/SF

Gruppe: Spezial- und Fingerkühlkörper

Kühlkörper für Mikroprozessoren (PGA, BGA, IC)

Für Halbleitergehäuse:	PGA, BGA, IC
Anzahl Halbleiter:	1
Halbleitermontage:	kleben
Kühlkörpermontage:	kleben
Oberfläche:	schwarz eloxiert
Wärmewiderstand:	5.6 K/W
Material:	AL 99,5



Kühlkörper für Mikroprozessoren (Fließpresstechnik)

Direktmontage durch hoch wärmeleitende Selbstklebefolie
(vormontiert)

Zusätzliche verbesserte Wärmeleitung durch reine
Aluminiumlegierung und hohe Materialdichte

Bestmögliche Wärmeabstrahlung durch schwarz eloxierte
Oberfläche

RthK- Werte gelten für natürliche Konvektion (ohne
Fremdbelüftung)

